

トランスクリプト

司会：冒頭のあいさつ

それでは、お時間となりましたので、東京エレクトロン株式会社 2023年3月期第2四半期の決算説明会を開始いたします。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。わたくし、司会進行を務めます、IR室の八田です。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の出席者の紹介をいたします。代表取締役社長・CEO 河合利樹でございます。

河合：河合です。よろしくお願いいたします。

続きまして、執行役員 Global Business Platform 副本部長 ファイナンス担当 川本弘でございます。

川本：川本でございます。本日はよろしくお願いいたします。

プレゼンテーションに先立ち、私から、本日の会の流れについてご説明させていただきます。これより、川本、河合のプレゼンテーションをお聞きいただきます。その後 18:30 まで、質疑応答のお時間を設け、皆さまからのご質問をお受けしたいと思っております。本説明会は、Webex を 2 回線使い、日英の同時通訳でおこなっております。先日、メールでご案内させていただいたとおり、音声のみお聞きになりたい方は、電話でもご参加いただけますが、ご質問されたい方は、PC もしくはモバイル端末のアプリをお使いください。また、本説明会は機関投資家様・アナリストさま向けの説明会となっております。大変申し訳ございませんが、回答は、従来通り機関投資家・アナリストの方々のご質問に限らせていただきます。本説明会につきましては、後日、日英の音声配信を HP 上に掲載しますので、こちらも併せてご利用ください。

それでは、はじめに、執行役員川本より、「連結決算の概要」についてご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

第2四半期 連結決算の概要

川本 弘（執行役員 ファイナンスユニット GM、Global Business Platform 本部 副本部長）

改めまして、ファイナンス部門を担当しております川本でございます。私の方から第2四半期の決算についてご報告申し上げます。

損益状況（四半期）：スライド4

ご覧のスライドは四半期ベースの業績でございます。第2四半期の数字は赤の枠で示しております。こちらは、四半期ベースの業績になります。

第2四半期の売上高は、前四半期比 49.7%増加の7,092 億円となりました。

第1四半期は、ロックダウンの影響による装置出荷や立上げの遅延、物流の混乱による部材不足が生じておりましたが、第2四半期にはそれらが解消し、上期の計画を上回る結果となりました。セグメント別に見ますと、SPE 売上高は、6,890 億円となり、こちらは四半期として過去最高となりました。FPD 売上高については、201 億円となっております。売上高、営業利益、営業利益率は過去最高値を記録し

トランスクリプト

ております。売上総利益率は、46.3%と高い水準を維持しました。

損益状況（四半期）：スライド5

こちらは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列でグラフに示したものになります。ご参考までにご覧ください。

損益状況（半期）：スライド6

続きまして、半期ベースの業績をご紹介します。赤枠の部分がこの上半期の結果でございます。今上期の売上高は、1兆1,828億円となり、公表値を上回って着地しました。半期としては過去最高の売上高となっております。セグメント別に見ますと、SPE売上高は予想を上回り、1兆1,530億円。FPD売上高は、297億円となり、こちらはほぼ予想通りの着地となりました。売上総利益率は44.7%、営業利益率につきましては29.6%となっております。

セグメント情報：スライド7

こちらは、セグメント情報となります。左側がSPE、真ん中がFPD、右側が構成比率でございます。主力のSPEは、売上高6,890億円、利益率は36.7%となりました。研究開発費などの成長投資は継続しておりますが、売上高が大幅に増加し、利益率は第一四半期比プラスの7.9%となっております。FPDについては、売上高201億円、利益率は10.0%となりました。売上構成比でございますが、この第2四半期は、SPEが97%、FPDは3%となっております。

SPE部門 地域別売上高：スライド8

こちらは、SPE部門の地域別の売上高でございます。ご覧の通り、日本、北米、台湾、中国と、多くの地域で第1四半期から売上高が大幅に増加いたしました。中国地域につきましては、第1四半期のロックダウン影響がございましたが、それが解消されております。

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比：スライド9

こちらは、SPE部門の新規装置のアプリケーション別売上構成比でございます。一番右側の第2四半期は、下から、ロジック61%、不揮発性メモリ24%、DRAM15%となりました。

フィールドソリューション売上高：スライド10

続きまして、こちらは、フィールドソリューション売上高になります。第2四半期は、1,317億円となりました。改造案件などの売上高増加に伴い、前四半期に比較いたしますと、20%の増加となりました。ご覧の通り、時間の経過とともに売上が増えていることが見て取れるかと思えます。

貸借対照表：スライド11

続きまして、BS貸借対照表に移ります。資産合計は、2兆1,380億円。現金同等物は、4,846億円。売上債権及び契約資産は、5,077億円。現金同等物、売上債権及び契約資産は売上高が増加したことにより、増加しております。棚卸資産は、5,529億円となっております。売上の計上に伴い、在庫は多く出荷されましたが、原材料の先行手配などから、棚卸資産の水準はほぼ横這いとなっております。負債は、

トランスクリプト

6,458 億円でございます。純資産でございますが、純利益獲得に伴い、1,773 億円増加し、1 兆 4,921 億円となりました。また、自己資本比率は 69.2%となっております。

キャッシュ・フロー：スライド 12

最後に、キャッシュ・フローについてご説明いたします。一番右側が直近の Q2 でございます。営業キャッシュ・フローは、1,934 億円を獲得いたしました。これは売上増による利益の計上が貢献したということでございます。投資キャッシュ・フローは、231 億円使用いたしました。財務キャッシュ・フローは、21 億円の使用。その結果、フリーキャッシュフローは、1,702 億円と高い水準となりました。以上、上期の連結決算の概要について、私からご報告させていただきました。

司会：次のプレゼンテーションの紹介

それでは、続きまして、CEO 河合より、「事業環境および業績予想」について、ご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

事業環境および業績予想

河合 利樹（代表取締役社長・CEO）

改めまして、皆さん、こんにちは。改めて、本日はお忙しいところありがとうございます。河合でございます。それでは私の方から「事業環境および業績予想」についてご説明申し上げます。

CY2022 事業環境（2022年11月時点での見方）：スライド 14

まず、事業環境についてご説明いたします。8月の決算報告時には、CY2022のWFE市場について、「前年比5%から15%の成長を見込む」とご説明しましたが、約10%程度の成長率で着地する見通しです。社会のデジタルシフトの進展、脱炭素社会の実現に向けた半導体の技術革新への期待より、当業界の中長期的な成長に対する見方に変更はございません。FPD TFT アレイ工程向け製造装置市場については変更なく、前年比微増を見込んでいます。

FY2023 Q2 事業進捗：スライド 15

次に、FY2023 第2四半期の事業進捗について説明します。ロジックおよび NAND 向けの売上が大きく伸長し、主力装置すべてにおいて出荷が大幅に拡大しました。その結果、売上高は 7,092 億円となり、過去最高の四半期売上高を達成することができました。また、営業利益率についても、四半期としては過去最高の 32.8%となりました。フィールドソリューションの売上も、メモリの微細化および多層化に向けたアップグレード・改造売上が順調に推移し、過去最高の 1,317 億円を計上しました。部材調達や物流等々の課題がある中、四半期で 7,000 億円を超える売上を達成できたことは、中期経営計画の目標である、売上高 3 兆円以上を目指すにあたっての、ひとつの試金石となり、大きな自信となりました。パートナー企業の皆さまのご協力の賜物であり、改めて、この強固なサプライチェーンが「当社の強み」

トランスクリプト

であると認識できた期となりました。また、戦略製品のペネトレーション、将来成長につながる開発 POR 選定も、中期経営計画どおり、着実に進捗しております。

主なハイライト：スライド 16

一例として、ご覧のような技術開発アイテムにおいて、Promising な結果を確認できており、着々と POR 獲得活動も進展しております。これらはすべて、当社の将来成長につながる、種となります。

FY2023 業績予想：スライド 17, 18

次に、FY2023 の業績予想について説明いたします。

既に公表されていますが、主に、メモリメーカーの設備投資の変更や、米国による中国への規制強化などを反映し、業績予想を修正いたします。通期売上高は 2 兆 1,000 億円、売上総利益は 9,100 億円、営業利益は 5,460 億円、親会社株主に帰属する当期純利益は、4,000 億円を予定しています。

FY2023 SPE 部門 新規装置売上予想：スライド 19

こちらは、SPE 部門新規装置の売上予想 となります。先程ご説明した、業績予想に基づき、FY2023 下期の新規装置売上予想を修正しました。上期は、過去最高の 9,177 億円となり、677 億円ほど、予想を上回って着地しました。下期見込みは 7,000 億円、通期で 1 兆 6,177 億円となる見込みです。CY ベースで、約 20% の成長を見込んでおります。また、FY ベースでも、過去最高を達成した前年通期に対し、約 8% 程度の成長と見ています。

中長期成長に向けた取り組み：スライド 20

さて、ここからは数スライドにわたって、中長期成長に向けた取り組みについてご説明させていただきます。

WFE Market：スライド 21

ICT、DX、脱炭素社会の構築に向け、半導体の重要性は、更に高まっているのは周知のとおりです。電気自動車や燃料電池自動車、そして自動運転の普及、AR・VR・MR と共にメタバースが更に普及して行きます。また、今後も「5G」通信が産業や社会に幅広く導入されていく一方、より高速・大容量・低遅延・多数同時接続を可能にするポスト 5G の開発が進展して行きます。このような新たな技術革新により、WFE 市場は継続的な成長を遂げて行きます。業界団体である SEMI が発表しているとおり、2022 年から 25 年にかけて新設される 300mm の工場およびラインは 67 にものぼり、装置需要は今後ますます伸びてゆくことが期待されます。

ロジックデバイス構造と EUV リソグラフィ技術の進化：スライド 22

工場やライン数の増加だけではなく、継続的な技術変化も、WFE 需要を牽引するドライバーとなります。ご覧のとおり、ロジックデバイスについては、約 2 年ごとに構造が進化します。現在、量産されている 3 nm FinFET 構造から、GAA : Gate All Around Nanosheet 構造を経て、CFET 構造へと進化し、高性能かつ低消費電力なデバイスが登場していきます。この複雑で、微細な構造を実現する、重要な技術の一つが EUV リソグラフィです。現在、すでに EUV は、量産プロセスに適用されていますが、更な

トランスクリプト

る微細化を実現する革新的な露光技術として、High NA EUVが1.4 nm ノードから導入される予定です。

imec および ASML 社との High-NA EUV の共同開発：スライド 23

この High NA EUV による次世代ロジックデバイスの開発に向けて、当社は imec、そして、ASML 社との共同開発を進めています。当社は、最先端デバイスの開発に向けて、世界中のお客さまと連携すると共に、このようなコンソーシアムならびに複数社によるコラボレーションを推進し、次世代デバイスの開発に、貢献していきます。

事業機会と注力分野（～FY2025）：スライド 24

こちらは、今後3年の事業機会と注力分野です。ロジックにおいては、2nmにおける低消費電力・高速CPUへのアプローチとして、GAA ナノシート、Backside PDN 構造が技術の変化の中心となります。DRAMにおいては、高速ワーキングメモリ DDR5 に向けて、EUV や、High-k Metal Gate が導入されます。NAND においては、大容量ストレージとしての高積層 Stacking、いよいよ300層へのアプローチが始まります。また、Multi-tier stacking や、異なるウェーハでつくったメモリセルと周辺回路を貼り合わせる技術などが採用されると期待されています。当社は、技術変化に対応した、幅広いプロダクトラインアップを持っており、特に、太字で示したようなエリアが大きな事業機会になると考えています。こうした付加価値の高い領域でシェアの拡大を目指しております。

フィールドソリューション事業のさらなる拡大：スライド 25

また、フィールドソリューション事業についても、今までの事業分野である、リニューアル装置や改造、パーツ販売のみならず、既存装置を有効活用した新たなソリューション提案も、今後の当社の成長を語る上では大変重要だと捉えています。データ活用に向けた装置や装置群に付帯するサーバーなどのインフラ整備、装置や処理ウェーハのプロセス状態を認識するためのセンシング技術の構築、デジタル・サポートツールを駆使した装置やプロセスのドメイン・ナレッジの分析・解析、そして、AIを活用した効率的なプロセス改善や装置機能の開発等々これらの取り組みを重ね、1つ1つを強化することで、最適なソリューションを提供し、装置のパフォーマンスの最大化と生産性の向上を図ります。それに加えて、IoT、Communication、Metaverse、Greenなどをキーワードに、フィールドソリューションの事業機会はますます拡大しており、成長に向けた戦略を検討しております。

中期経営計画：スライド 26

これらのさまざまな活動を通じて今年6月に発表した、中期経営計画の達成に向け、邁進してまいります。売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を目指し、5年以内に、東証プライム市場における唯一無二の存在となるよう、市場成長をアウトパフォームし、さらなる発展に努めてまいります。

FY2023 研究開発費・設備投資計画：スライド 27

次に、研究開発費と設備投資の計画です。こちらは変更ございません。すでにお伝えしている通り、今

トランスクリプト

後5年間で、研究開発費は1兆円以上、設備投資は評価装置等を中心に、4,000億円以上を計画しております。中期経営計画の達成に向け、積極的な研究開発と設備投資を継続していきます。

FY2023 配当予想：スライド 28

最後に、配当予想についてです。中間配当は過去最高の857円、期末につきましては、業績予想修正に基づき、425円を予定しております。東京エレクトロンは、明日11月11日、創立60年目を迎えます。今期は、過去最高の売上となる見通しですが、将来への成長を見据えた様々な取り組みをさらに推進しており、戦略装置によるPOR獲得も順調に進捗しております。これまで、当社の成長をご支援いただきました株主の皆さまへの感謝を込めて、期末に、1株あたり200円の記念配当を計上する予定です。以上、私からのご説明となりました。どうもありがとうございます。